仅供内部参考，请勿外传！

电子

大模型持续升级，国产超节点开启军备竞赛

大模型参数持续膨胀，超节点成为 AI 基础设施核心赛道。随着行业从训练时代逐步迈向推理时代，从参数规模竞赛走向 Agent（智能体）等应用落地，决定 AI 系统能力的关键因素，正从单颗芯片性能逐渐转向整个计算系统的组织效率。系统互联、通信时延、内存共享以及集群调度能力，开始成为下一轮 AI 基础设施竞争的核心。全球 AI 竞争的重心正在向基础设施加速转移。《超节点定义与实践白皮书》于 7 月 19 日正式发布、行业统一标准落地确立全新基建范式，多重产业信号共振预示超节点即将迎来放量元年。2027-2028 年国内大模型参数有望攀升至 3000 亿-6000 亿级别，超大模型训练推理需求将持续拉动超节点规模化采购。据赢渔产业研究院测算，2028 年国产超节点市场空间有望达到 3414 亿元，2026 年至 2028 年复合年均增长率高达 194%。

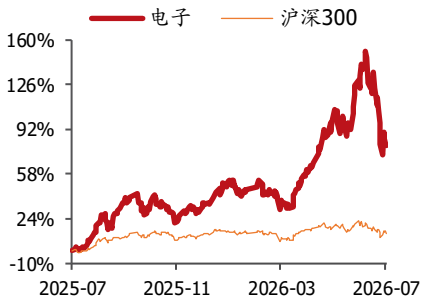
国产超节点百花齐放，系统架构创新有望弥补单点算力差距。国内厂商在超节点集群能力上已形成差异化领先优势，有望依靠系统层创新补齐单点芯片短板，国产软硬件产业成熟叠加标准化落地、终端需求起量，将共同支撑超节点进入规模化放量新阶段。国产厂商陆续发布超节点方案。昇腾 950 超节点：基于灵衢互联协议，以单柜 64 卡为基本单元，实现业界最大 1024 卡规模，提供 1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4 算力，拥有 256TB 全局统一内存编址空间，依托 TB 级 NPU 互联超大带宽与 3μs 超低 RTT 时延。满配系统由 128 个计算柜和 32 个互联柜组成，搭载 8192 颗芯片，总算力达 8 EFLOPS，计划 2026 年 Q4 上市。摩尔线程 MTT C256 超节点：采用计算与交换一体化的高密设计，突破业界普遍的一层网络 64 卡限制，MTT C256 首次在一层 Scale-up 网络中实现 256 卡全互联；单机柜 GPU 密度领先行业，仅通过两个标准机柜即可实现 256 卡的一层 Scale-up 极速互联，在大幅提高智算中心 GPU 部署密度的同时，有效节省了机房空间；采用 2U 节点设计，完美兼容现有的智算软硬件生态，支持集群从万卡向十万卡级平滑扩展。壁仞科技：基于 BR2xx 和 BLink™2.0，构建了三级超节点产品矩阵：16 卡标准服务器超节点（电互连）、128 卡高密整机柜超节点（电互连）、以及 1024 卡分布式解耦架构超节点（NPO 光互连）。16 卡/128 卡超节点适用于中小客户/千亿-万亿参数落地需求，NPO 光互连、大规模扩展超节点尤其适用于大客户/数万亿参数场景，客户可以按需选择，灵活扩展。沐曦股份曦景 S600：定位于新一代 AI 超节点产品，围绕高密度部署、高速互连和软硬协同进行全面优化，可实现单机柜 64 张 GPU 高速全互连，并支持灵活扩展至万卡级集群，满足大模型训练、推理及智算中心建设等需求，为向更大规模的超算集群拓展打下良好基础。中科曙光 8000（登峰）：2026 年 7 月正式落成，是中国首个全国产十万卡 AI 超集群，已接入国家超算互联网，面向全国政企、科研机构开放算力服务。集群兼容 FP64 高精度科研计算与 INT8 大模型推理全场景负载，在 MoE 万亿参数模型训推场景可实现 30%-40%的性能提升。

投资建议：见第二章相关标的。

风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、地缘政治风险。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 余凌星
执业证书编号：S0680525010004
邮箱：shelingxing1@gszq.com
分析师 钟琳
号：S0680525010003
邮箱：zhonglin1@gszq.com
分析师 朱迪
执业证书编号：S0680525100002
邮箱：zhudi@gszq.com

相关研究

1、《电子：周观点：台积电业绩超预期，WAIC 释放 AI 产业化信号》 2026-07-19

2、《电子：周观点：国产算力斜率陡峭，SLC NAND 价值重估》 2026-07-11

3、《电子：SLC NAND：老树也能开新花》 2026-07-02

内容目录

一、大模型持续升级，国产超节点开启军备竞赛 3
1.1 大模型参数持续膨胀，超节点成为 AI 基础设施核心赛道 3
1.2 国产超节点百花齐放，系统架构创新有望弥补单点算力差距 5
二、相关标的 12
风险提示 12

图表目录

图表 1：Kimi K3 以 1679 分登顶 Frontend Code Arena 前端代码榜 3
图表 2：华为昇腾 Altas 950 超节点 4
图表 3：清微智能可重构超节点 4
图表 4：鹏城实验室（PCL）与全球计算联盟（GCC）共同发布了《超节点定义与实践白皮书》 5
图表 5：华为云 CM384 与 GB200 NVL72 性能对比 6
图表 6：华为昇腾 950 超节点 7
图表 7：中科曙光 8000——万卡 AI 超集群 8
图表 8：摩尔线程 MTT C256 超节点 9
图表 9：壁仞科技超节点总体演进路线和产品矩阵 10
图表 10：沐曦股份曦景 S600 超节点 11



一、大模型持续升级，国产超节点开启军备竞赛

1.1 大模型参数持续膨胀，超节点成为 AI 基础设施核心赛道

国产芯片与大模型百花齐放，WAIC26 规模创历届之最。本届大会吸引 1100 余家全球企业参展，集中展示 3000 余项前沿成果，其中超过 300 款产品为全球首发；现场统计则显示，大会共涉及 108 款芯片、261 款大模型、208 款具身智能终端及超 300 台真机，展会总面积超过 10 万平方米，张江展区更单独为“中国芯片”开设专区，覆盖华为、沐曦、摩尔线程、天数等 40 余家国产算力相关企业。模型层面最受关注的是月之暗面 Kimi 在展前发布的 Kimi K3，参数规模达 2.8 万亿，凭借自研的 KDA（Kimi Delta Attention）与 AttnRes（Attention Residuals）架构等创新，在基准测试上对海外前沿模型持续追分。

图表1：Kimi K3 以 1679 分登顶 Frontend Code Arena 前端代码榜



资料来源：Arena AI，环球时报，国盛证券研究所

大模型参数持续膨胀，算力集群与服务器需求攀升，超节点成为刚需。Kimi K3 发布后，壁仞科技 AI 框架架构副总裁丁云帆预测，明年有望出现 5 万亿参数模型，沐曦股份研发副总裁黄向军也表示业界较激进的预测已达 5 万亿、6 万亿级别。这一需求已在实际运营中体现为算力紧张：Kimi K3 上线后用户请求量大幅超出预估、逼近现有集群承载极

限，月之暗面一度暂停 C 端新用户订阅，创始人杨植麟披露 2026 年计划将参数规模推向新量级，需数万张高端 GPU 持续训练；参数增长也直接推高单模型所需的卡量与集群规模：7000 多亿至 1 万亿参数模型采用典型的 PD 分离（预填充与解码分离）部署时，P、D 节点各用 16 张左右算力卡即可支持，但参数量超万亿后所需算力、显存容量和卡的数量均成倍增长。万卡集群尚可不依赖超节点，但十万卡集群不能依靠堆砌上千台服务器运行，需要将多个超节点组成 POD、再由多个 POD 组成更大集群。据赢渔产业研究院测算，2028 年国产超节点市场空间有望达到 3414 亿元，2026 年至 2028 年复合年均增长率高达 194%。超节点产能正快速上量。

国产超节点集中亮相，AI 算力迈入“系统时代”。随着行业从训练时代逐步迈向推理时代，从参数规模竞赛走向 Agent（智能体）等应用落地，决定 AI 系统能力的关键因素，正从单颗芯片性能逐渐转向整个计算系统的组织效率。系统互联、通信时延、内存共享以及集群调度能力，开始成为下一轮 AI 基础设施竞争的核心。全球 AI 竞争的重心正在向基础设施加速转移，涵盖华为、新华三、燧原科技、沐曦、摩尔线程、中兴、阿里、昆仑芯、壁仞科技等多家国内厂商在今年 WAIC 展出超节点产品。产业协同的特征亦十分突出：中兴通讯联合曦智科技壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天数智芯等多家国产 GPU 厂商，基于 OEX+dOCS 架构打造了国产高性能 Matrix 超节点，并已入围 WAIC 卓越人工智能引领者（SAIL 奖）TOP30 榜单。其中，华为昇腾 950 超节点（Atlas 950 SuperPoD）首次以真机形态公开亮相。这一趋势也得到权威机构印证：中国信通院在《超节点发展报告》中明确提出“超节点将成为 AI 时代的核心计算单元”，华为轮值董事长徐直军亦将公司整体算力战略概括为“超节点+集群”。

图表2：华为昇腾 Altas 950 超节点



资料来源：腾讯科技，国盛证券研究所

图表3：清微智能可重构超节点



资料来源：腾讯科技，国盛证券研究所

《超节点定义与实践白皮书》发布，标志着其 AI 基础设施建设新范式的确立。7 月 19 日，鹏城实验室（PCL）与全球计算联盟（GCC）牵头，联合京东、百度、中国电信、中国移动、华为、商汤科技、清华大学、北京大学等三十余家机构共同发布《超节点定义与实践白皮书》，首次给出完整定义：超节点是一种在物理上由多个计算节点通过高效互联协议紧密连接组成、具备跨物理节点统一内存编址能力、逻辑上具备“一台计算机”特征的计算系统，其中“内存语义”和“统一内存编址”、超低时延、超大带宽共同构成三大技术特征。具体标准上，可支持 32 及以上 AI 芯片，AI 芯片到交换芯片带宽不小于 400GB/s，设备时延小于 500 纳秒。从产品实践看，沐曦股份本届大会首发的曦景 S600 超节点即为例证：单机柜实现 64 卡高密度部署，通过柜内全互连架构大幅降低数据交互时延，并灵活支持 EP、TP 等多维并行策略，全面覆盖大模型训练和推理场景。根据沐曦股份联合创始人、CTO 兼首席软件架构师杨建预判，到 2027 年中国大模型参数规模将突破 3000 亿，2028 年达 5000 亿至 6000 亿，超节点形态对于超大模型推理的性价比价值将愈发凸显。

图表4：鹏城实验室（PCL）与全球计算联盟（GCC）共同发布了《超节点定义与实践白皮书》



资料来源：C114 通信网，国盛证券研究所

1.2 国产超节点百花齐放，系统架构创新有望弥补单点算力差距

超节点国内已呈现部分领先的态势，有望以集群与架构优势弥补与海外龙头的单芯片性能差距。目前英伟达 GB300 NVLink 72 与 AMD Helios UALoE72 所采用的均为 72 卡 Cable Tray 路线，业界人士反馈海外尚无更大规模的落地方案，而国内华为昇腾 950 超节点等产品已实现 1024 卡规模。从系统对比数据看，SemiAnalysis 数据显示，单颗昇腾芯片性能约为英伟达 Blackwell 架构 GPU 的三分之一，但通过超节点集群方式，单个 CloudMatrix 384 集群 BF16 性能总体是 GB200 NVL72 的 1.7 倍，总内存容量为后者的 3.6 倍，总内存带宽为后者的 2.1 倍，系统架构创新有效弥补了国产芯片在单点算力上的差距。

图表5：华为云 CM384 与 GB200 NVL72 性能对比

Key Capabilities - Huawei Ascend 910C Cloud Matrix 384 vs Nvidia GB200 NVL72				
Chip and Package Level				
	Unit	GB200	Ascend 910C	Huawei vs Nvidia
BF16 dense TFLOPS	TFLOPS	2,500	780	0.3x
HBM capacity	GB	192	128	0.7x
HBM bandwidth	TB/s	8.0	3.2	0.4x
Scale Up Bandwidth	Gb/s uni-di	7,200	2,800	0.4x
Scale Out Bandwidth	Gb/s uni-di	400	400	1.0x
System Level				
	Unit	Nvidia GB200 NVL72	Cloud Matrix CM384	Huawei vs Nvidia
BF16 dense PFLOPS	PFLOPS	180	300	1.7x
HBM capacity	TB	13.8	49.2	3.6x
HBM bandwidth	TB/s	576	1,229	2.1x
Scale Up Bandwidth	Gb/s uni-di	518,400	1,075,200	2.1x
Scale Up Domain Size	GPUs	72	384	5.3x
Scale Out Bandwidth	Gb/s uni-di	28,800	153,600	5.3x
All-In System Power[1]	W	145,000	559,378	3.9x
All-in Power per BF16 dense FLOP	W/TFLOP	0.81	1.87	2.3x
All-in Power per memory bandwidth	W per TB/s	251.7	455.2	1.8x
All-in Power per memory capacity	kW/TB	10.5	11.4	1.1x

1. All-in System Power is total cluster power including scale-out networking, storage, etc.

资料来源：SemiAnalysis，央视网，国盛证券研究所

国产厂商陆续发布超节点方案，AI 基础设施的竞争正从单芯片性能转向系统级能力。

华为昇腾

昇腾 384 超节点：已累计商用落地 750 多套，成为国内唯一规模商用的超节点，也是国内唯一训练出 SOTA（State-of-the-Art）模型的超节点。规模化应用于互联网、运营商、金融、医疗、交通、制造等 20 多个行业。

昇腾 950 超节点：WAIC 2026 上首次真机亮相。基于灵衢互联协议，以单柜 64 卡为基本单元，实现业界最大 1024 卡规模，提供 1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4 算力，拥有 256TB 全局统一内存编址空间，依托 TB 级 NPU 互联超大带宽与 3μs 超低 RTT 时延。满配系统由 128 个计算柜和 32 个互联柜组成，搭载 8192 颗芯片，总算力达 8 EFLOPS，计划 2026 年 Q4 上市。该产品斩获 WAIC 最高荣誉 SAIL 大奖。

Atlas 850E 风冷超节点：针对传统风冷机房设计，无需液冷改造即可部署，单超节点可扩展至 96 卡商用部署，覆盖 FP8、FP4 等全量低精度格式，可稳定实现 10 毫秒级时延推理。

互联协议：华为发布了面向超节点的互联协议“灵衢”，灵衢 2.0 技术规范已正式开放，共建开放生态。

图表6：华为昇腾 950 超节点



资料来源：赢渔产融，国盛证券研究所

中科曙光

曙光 8000（登峰）：2026 年 7 月正式落成，是中国首个全国产十万卡 AI 超集群，已接入国家超算互联网，面向全国政企、科研机构开放算力服务。集群兼容 FP64 高精度科研计算与 INT8 大模型推理全场景负载，在 MoE 万亿参数模型训推场景可实现 30%-40%的性能提升。

超节点 scaleX40：2026 年 3 月发布，全球首个无线缆箱式超节点。单节点集成 40 张 GPU，总算力超过 28PFLOPS（FP8 精度），HBM 显存容量超 5TB，访存带宽超 80TB/s，系统可靠性达 99.99%。其核心价值在于通过无线缆架构降低部署门槛，让超节点从 “少数人的能力” 变成 “多数人的标配”。

超节点 scaleX640：2025 年 11 月发布，单机柜可集成 640 张国产加速卡，依托 scaleFabric 无损高速网络完成十万卡统一组网调度。

图表7：中科曙光 8000——万卡 AI 超集群



资料来源：赢渔产融，国盛证券研究所

摩尔线程

MTT C256 超节点采用计算与交换一体化的高密设计，具备三大核心优势：

极致互联：突破业界普遍的一层网络 64 卡限制，MTT C256 首次在一层 Scale-up 网络中实现 256 卡全互联。这使得卡间通信延迟被压缩至亚微秒级，带宽利用率显著提升，为大模型分布式并行策略的优化提供了更广阔的空间。

高密度部署：单机柜 GPU 密度领先行业，仅通过两个标准机柜即可实现 256 卡的一层 Scale-up 极速互联，在大幅提高智算中心 GPU 部署密度的同时，有效节省了机房空间。

生态与工程兼容：采用 2U 节点设计，完美兼容现有的智算软硬件生态，支持集群从万卡向十万卡级平滑扩展。

此外，MTT C256 超节点在工程化设计上也展现了突出优势。通过高效液冷散热、三盲插设计、完善的 RAS（可靠性、可用性、可服务性）机制以及配套的集群管理系统，保障了超节点在大规模部署下的长期稳定运行与便捷维护。

图表8：摩尔线程 MTT C256 超节点



资料来源：与非网，国盛证券研究所

壁仞科技

壁仞科技正式推出下一代 NPO 光互连、分布式解耦架构超节点方案，支持单个超节点 1024 卡 Scale-up 扩展。

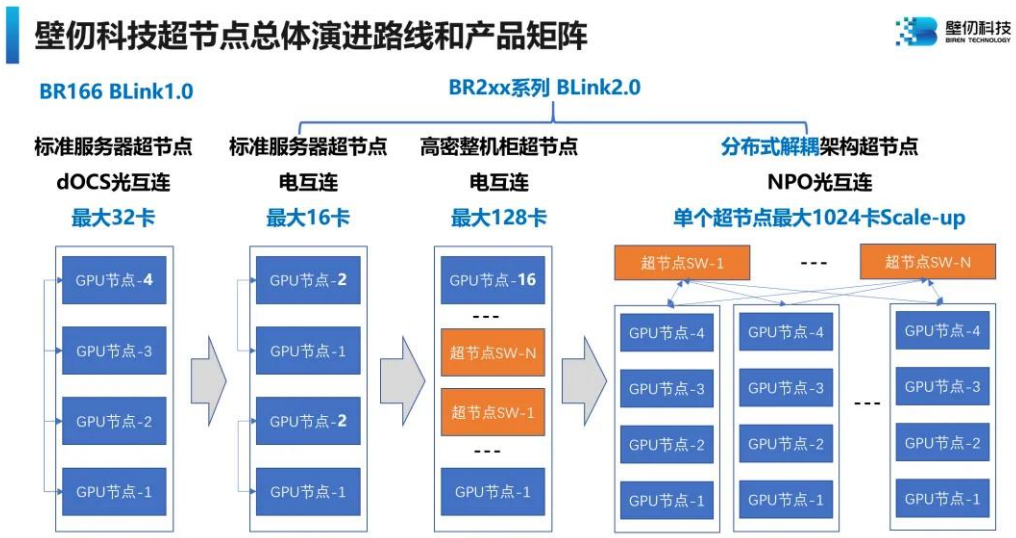
芯片——壁仞科技业界首创 Chiplet（芯粒）架构大算力芯片，新一代 BR2xx 系列 GPU 沿用这一技术路线。BR2xx 支持 FP8/FP4 低精度高算力计算，拥有更大显存带宽，并原生集成了超节点互连能力，是整套方案的算力基石。

协议——壁仞科技自研的 BLink™2.0 超节点互连协议，是连接所有 GPU 的“神经系统”。BLink™2.0 核心能力概括为四个方面：一是内存语义互连，让最多 1024 张 GPU 共享同一个内存空间，多卡如同一台“超级 GPU”；二是在网计算，将通信中的数学运算下沉到交换机完成，减轻 GPU 负担；三是智能拥塞控制，避免网络堵塞；四是多层链路自愈，从物理层到框架层逐级防护，保障训练推理不中断。

产品矩阵——基于 BR2xx 和 BLink™2.0，壁仞科技构建了三级超节点产品矩阵：16 卡标准服务器超节点（电互连）、128 卡高密整机柜超节点（电互连）、以及 1024 卡分布式解耦架构超节点（NPO 光互连）。16 卡/128 卡超节点适用于中小客户/千亿-万亿参数落地需求，NPO 光互连、大规模扩展超节点尤其适用于大客户/数万亿参数场景，客户可以按需选择，灵活扩展。

应用方案——壁仞科技“Token 工厂”解决方案。在 Agentic AI 场景中，每次 AI 对话都会产生大量中间计算结果（KV Cache），如果每次都重新计算，算力浪费巨大。壁仞科技通过五级分层缓存架构，实现了 95%以上的缓存命中率，大幅降低重复计算开销。同时，壁仞科技联合中国电信首创跨厂商异构混推方案，充分发挥异构算力优势，有效吞吐提升 20%。在容错保障方面，即使单个 GPU 发生故障，框架层也能自动隔离故障节点、感知超节点拓扑重新组网，确保业务不中断，为大规模超节点集群的工程落地和长期稳定运行提供了最终根本保障。

图表9：壁仞科技超节点总体演进路线和产品矩阵



资料来源：上海市互联网业联合会，国盛证券研究所

沐曦股份

曦景 S600 定位于新一代 AI 超节点产品，围绕高密度部署、高速互连和软硬协同进行全面优化，可实现单机柜 64 张 GPU 高速全互连，并支持灵活扩展至万卡级集群，满足大模型训练、推理及智算中心建设等需求，为向更大规模的超算集群拓展打下良好基础。

曦景 S600 采用 OEX 架构设计，通过正交连接器与两级交换拓扑，实现 GPU 之间低时延、高带宽通信，有效提升分布式训练效率，能够更好满足 MoE 稀疏模型、万亿参数大模型等复杂 AI 任务对集群通信能力的要求。

曦景 S600 通过采用“三 0 设计”方案，实现计算节点 0 线缆、交换节点 0 线缆以及计算节点与交换节点之间 0 线缆，大幅减少复杂布线带来的信号损耗和故障风险，进一步提升系统可靠性和长期稳定运行能力。同时，产品采用解耦模块化设计，计算、交换、电源及液冷等关键模块均支持快速部署和维护，电源与液冷管路支持盲插热插拔，即使单节点发生故障，也不会影响整个集群运行，显著降低数据中心运维成本。目前沐曦在单个 GPU 或者单节点 8 卡机柜的故障率已经控制到非常低，跟国际主流厂商在同一水平线。

图表10：沐曦股份曦景 S600 超节点



资料来源：证券市场周刊，国盛证券研究所

二、相关标的

国产算力芯片：芯原股份、沐曦股份、海光信息、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、灿芯股份、翱捷科技等；

超节点：盛科通信、华勤技术、澜起科技等；

代工：中芯国际、华虹半导体；

SLC NAND：江波龙、兆易创新、香农芯创、联芸科技、东芯股份、普冉股份、聚辰股份等；
玻璃基板：京东方、华灿光电、天承科技、帝尔激光等；

硅片：立昂微、沪硅产业、西安奕材等；

MLCC 及产业链：三环集团、洁美科技、风华高科、博迁新材、国瓷材料；磷化铟衬底：云南锗业；

PCB 产业链：胜宏科技、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、天承科技、中钨高新、鼎泰高科、大族数控等；

光产业链：东山精密（索尔思）、炬光科技、腾景科技、源杰科技、豪威集团、天孚通信、中际旭创、新易盛、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、永鼎股份、太辰光、光库科技、赛微电子等；

半导体设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、华峰测控、金海通等；

半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、天承科技、彤程新材、安集科技、兴森科技、兴福电子等；

封测：盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技、甬矽电子、汇成股份、伟测科技、利扬芯片等。

风险提示

1. 下游需求不及预期。
2. 研发进展不及预期。
3. 地缘政治风险。

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券”股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京
地址：北京市丰台区丽泽路 22 号院新华社国家金融信息大厦西塔 B 座 38 层
邮编：100077
邮箱：gsresearch@gszq.com

上海
地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
邮编：200120
电话：021-38124100
邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌
地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
邮编：330038
传真：0791-86281485
邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳
地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
邮编：518033
邮箱：gsresearch@gszq.com